

## ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

### 1. ค่าเฉลี่ยกำลังแรงขีดชนิดเฉือน/ปอก

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังแรงขีดชนิดเฉือน/ปอกระหว่างแบรอกเกต กับพิวเคลือบฟันเมื่อใช้คอมโพสิตเรซิโนนเป็นวัสดุขีดติด เมื่อใช้กาวไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุขีดติดโดยไม่ทำการเตรียมพิวเคลือบฟัน เมื่อใช้กาวไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุขีดติดโดยเตรียมพิวเคลือบฟันด้วยการใช้กรดกัด ขณะเมื่อใช้กาวไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุขีดติดโดยเตรียมพิวเคลือบฟันด้วยการใช้กรดกัด ตามด้วยการทำอนดิงเรซิโนน มีค่าเท่ากับ  $16.29 \pm 2.23$ ,  $5.88 \pm 2.46$ ,  $13.42 \pm 1.64$  และ  $13.70 \pm 2.19$  เมกะปascal ตามลำดับ (ตารางที่ 1, ภาพที่ 29)

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบ เชฟฟี่ (Scheffe Test) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ปรากฏได้ดังนี้ (ตารางที่ 2 และ 3)

กำลังแรงขีดชนิดเฉือน/ปอกระหว่างแบรอกเกตกับพิวเคลือบฟันเมื่อใช้กาวไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุขีดติดโดยไม่ทำการเตรียมพิวเคลือบฟันมีค่าต่ำกว่ากันอย่างมีนัยสำคัญ ( $p<0.05$ )

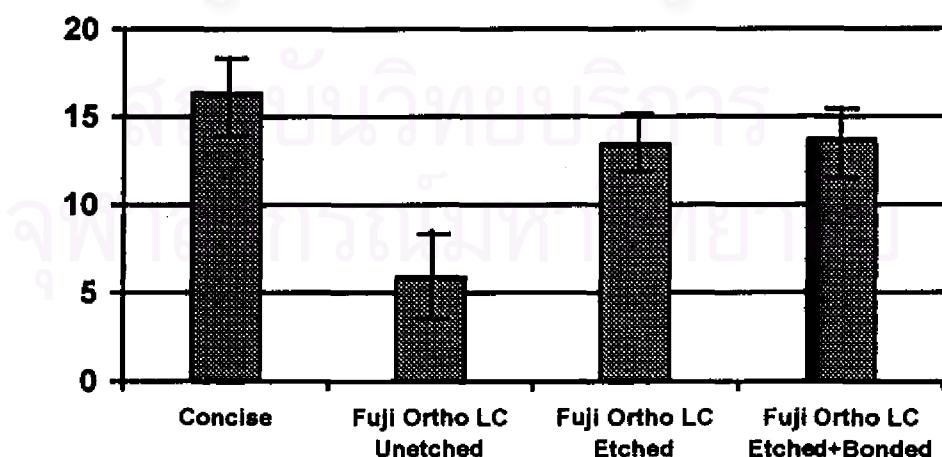
กำลังแรงขีดชนิดเฉือน/ปอกระหว่างแบรอกเกตกับพิวเคลือบฟันเมื่อใช้กาวไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุขีดติดโดยเตรียมพิวเคลือบฟันด้วยการใช้กรดกัด และเมื่อใช้กาวไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุขีดติดโดยเตรียมพิวเคลือบฟัน ด้วยการใช้กรดกัดตามด้วยการทำอนดิงเรซิโนน มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ต่ำกว่าเมื่อใช้คอมโพสิตเรซิโนนเป็นวัสดุขีดติดอย่างมีนัยสำคัญ ( $p<0.05$ )

กำลังแรงขีดชนิดเฉือน/ปอกระหว่างแบรอกเกตกับพิวเคลือบฟันเมื่อใช้คอมโพสิตเรซิโนนเป็นวัสดุขีดติดมีค่าสูงกว่ากันอย่างมีนัยสำคัญ ( $p<0.05$ )

Adhesive/enamel surface treatment	Mean shear/peel bond strength (Mpa)	Maximum shear/peel bond strength (Mpa)	Minimum shear/peel bond strength (Mpa)	Standard deviation (Mpa)
Concise	16.29	20.35	12.72	2.23
Fuji Ortho LC / Unetched	5.88	10.43	2.80	2.46
Fuji Ortho LC / Etched	13.41	16.02	10.68	1.64
Fuji Ortho LC / Etched+Bonded	13.70	18.56	10.17	2.19

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด-ต่ำสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกำลังแรงยึดชนิด เฉือน/ปอก ระหว่างแบบรากเกตและพิวเคลติอบฟันเมื่อใช้วัสดุขึ้นติดและวิธีการเตรียมพิวเคลติอบฟันที่แตกต่างกัน

Shear/peel bond strength (MPa)



ภาพที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังแรงยึดชนิดเฉือน/ปอกระหว่างแบบรากเกตและพิวเคลติอบฟันเมื่อใช้วัสดุขึ้นติดและวิธีการเตรียมพิวเคลติอบฟันที่แตกต่างกัน

Source of variation	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between groups	1812.59	3	604.19	130.46	0.00
Within groups	537.23	116	4.63		
Total	2349.81	119			

**ตารางที่ 2** ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(One way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

	(Group 1) Concise	(Group 2) Fuji Ortho LC / Unetched	(Group 3) Fuji Ortho LC / Etched	(Group 4) Fuji Ortho LC / Etched+Bonded
(Group 1) Concise		10.42*	2.87*	2.59*
(Group 2) Fuji Ortho LC / Unetched	10.42*		7.54*	7.82*
(Group 3) Fuji Ortho LC / Etched	2.87*	7.54*		2.8
(Group 4) Fuji Ortho LC / Etched+Bonded	2.59*	7.82*	2.8	

\* Significant at  $p < 0.05$

**ตารางที่ 3** ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การทดสอบ เชฟเฟ่ (Scheffe Test)  
ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

**2. นิเวชที่เกิดความถัมภ์ทางของการขัดดัด**  
**ทดสอบโดยใช้ค่าดัชนีการเหลืออยู่ของวัสดุขัดดัด (Adhesive Remnance Index = ARI) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4**

Adhesive/enamel surface treatment	ARI=0	ARI=1	ARI=2	ARI=3
Concise	0 (0%)	18 (60%)	10 (33.33%)	2 (6.67%)
Fuji Ortho LC / Unetched	28 (93.33%)	2 (6.67%)	0 (0%)	0 (0%)
Fuji Ortho LC / Etched	0 (0%)	1 (3.33%)	6 (2%)	23 (76.67%)
Fuji Ortho LC / Etched+Bonded	0 (0%)	1 (3.33%)	7 (23.33%)	22 (73.33%)

**ตารางที่ 4 แสดงค่าดัชนีการเหลืออยู่ของวัสดุขัดดัด**

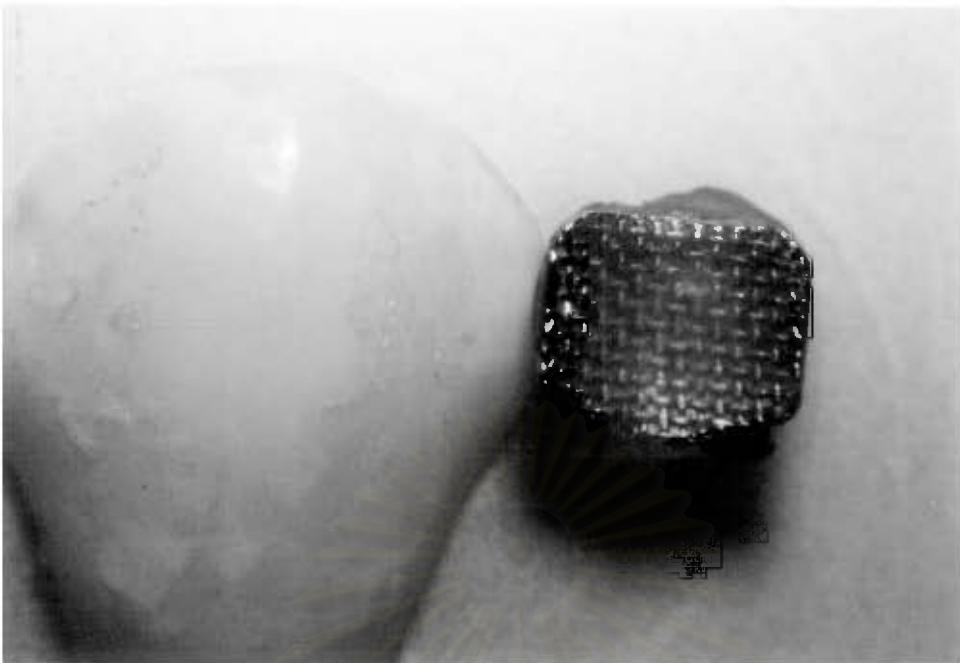
ARI=0 หมายถึง ไม่มีวัสดุขัดดัดเหลืออยู่บนผิวเคลือบฟัน

ARI=1 หมายถึง มีวัสดุขัดดัดเหลืออยู่บนผิวเคลือบฟันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของฟันที่ฐานแบกรอก

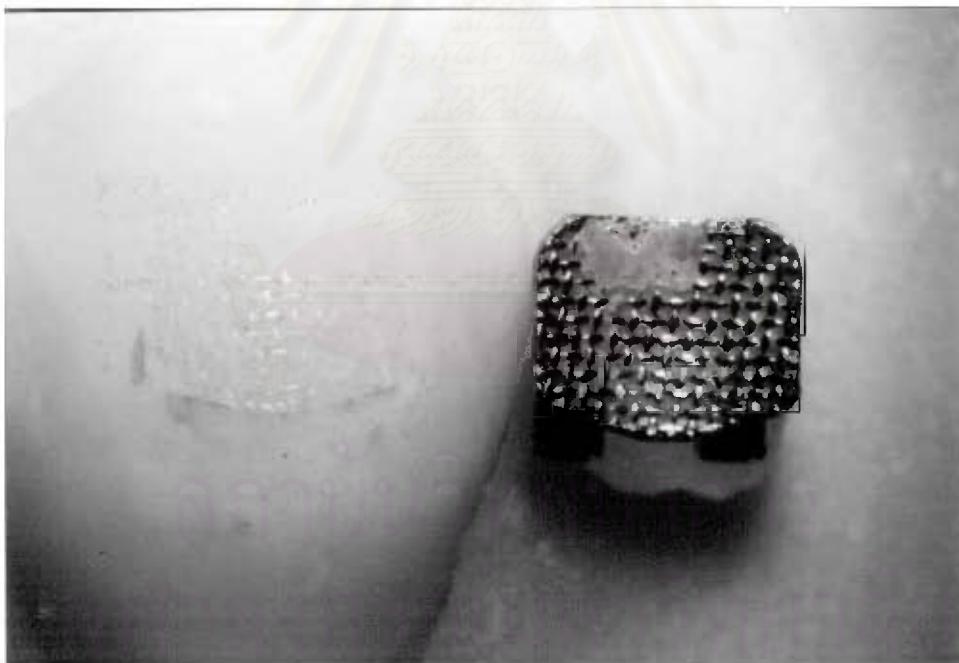
ARI=2 หมายถึง มีวัสดุขัดดัดเหลืออยู่บนผิวเคลือบฟันมากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ไม่ถึงทั้งหมดของฟันที่ฐานแบกรอก

ARI=3 หมายถึง วัสดุขัดดัดทั้งหมดเหลือติดอยู่บนผิวเคลือบฟัน

จากผลการทดสอบพบว่าในครุ่นที่ใช้คอมโพสิตเป็นวัสดุขัดดัดส่วนใหญ่จะมีค่าดัชนีการเหลืออยู่ของวัสดุขัดดัดเท่ากับ 1 และ 2 แสดงว่าเกิดความถัมภ์ทางการขัดระหว่างวัสดุขัดดัดกับผิวเคลือบฟันและความถัมภ์ทางกายในเนื้อของวัสดุขัดดัด (adhesive/cohesive failure) (ภาพที่ 30,31)



ภาพที่ 30 แสดงบริเวณที่เกิดความล้มเหลวของวัสดุชีดติด ( $ARI=1$ )



ภาพที่ 31 แสดงบริเวณที่เกิดความล้มเหลวของวัสดุชีดติด ( $ARI=2$ )

กุ่มที่ใช้กากาสไโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแฟรงเป็นวัสดุชีดติดโดยไม่เตรียมผิว เกตีอบฟัน ส่วนใหญ่จะมีค่าตัวชี้การหล่ออยู่ของวัสดุชีดติดเท่ากับ 0 แสดงว่าเกิดความล้มเหลวที่การยึดระหว่างวัสดุชีดติดกับผิวเกตีอบฟัน (adhesive failure) (ภาพที่ 32)



ภาพที่ 32 แฟลกงบริเวณที่เกิดความล้มเหลวของวัสดุขึ้นติด (ARI=0)

กตุ่นที่ใช้กาวไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุขึ้นติด โดยเริ่มต้นด้วยการใช้กรรไกร และกตุ่นที่ใช้กาวไอโอดีโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเป็นวัสดุขึ้นติด โดยเริ่มต้นด้วยการใช้กรรไกรตามด้วยการทابบนดึงเรซิน ส่วนใหญ่จะมีค่าดัชนีการเหลืองอยู่ของวัสดุขึ้นติดเท่ากับ 3 แสดงว่าเกิดความล้มเหลวภายในเนื้อของวัสดุขึ้นติด (ภาพที่ 33)



ภาพที่ 33 แฟลกงบริเวณที่เกิดความล้มเหลวของวัสดุขึ้นติด (ARI=3)

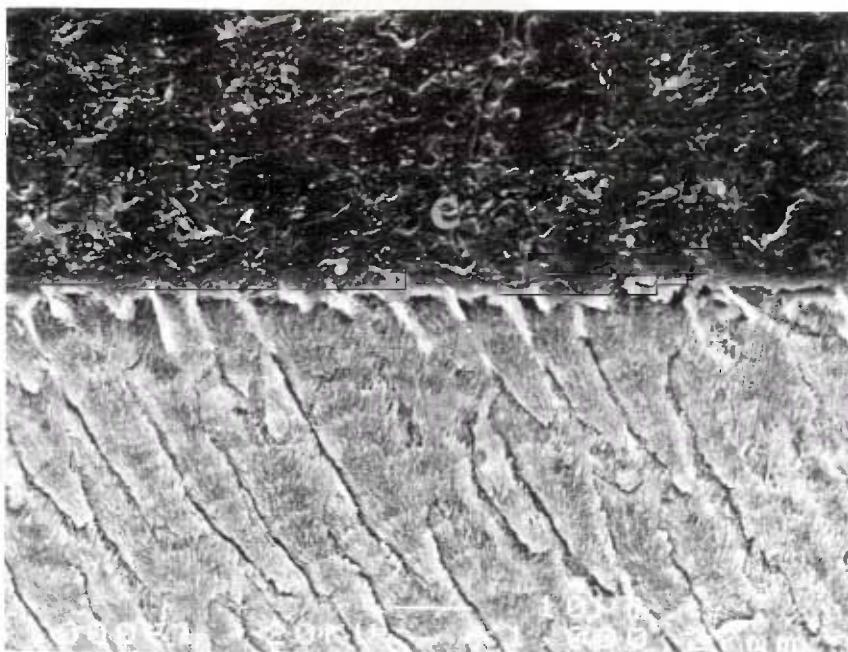
### 3. ก้าวเด้ายางก็อองธูกรคนอิเกคตรอน

พบว่าการยึดระหว่างคอมโพสิตเทเรซินกับผิวเคลือบฟันเกิดจากคอมโพสิตเทเรซินยึดกับบนดิงเรชินที่แทรกซึมเข้าไปในร่องที่เกิดจากการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน (ภาพที่ 34)

การยึดระหว่างกัลยาโน่ไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงกับผิวเคลือบฟันเมื่อไม่เครื่ยมผิวเคลือบฟัน พบว่าไม่มีการแทรกซึมของกัลยาโน่ไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเข้าไปในเคลือบฟัน (ภาพที่ 35)

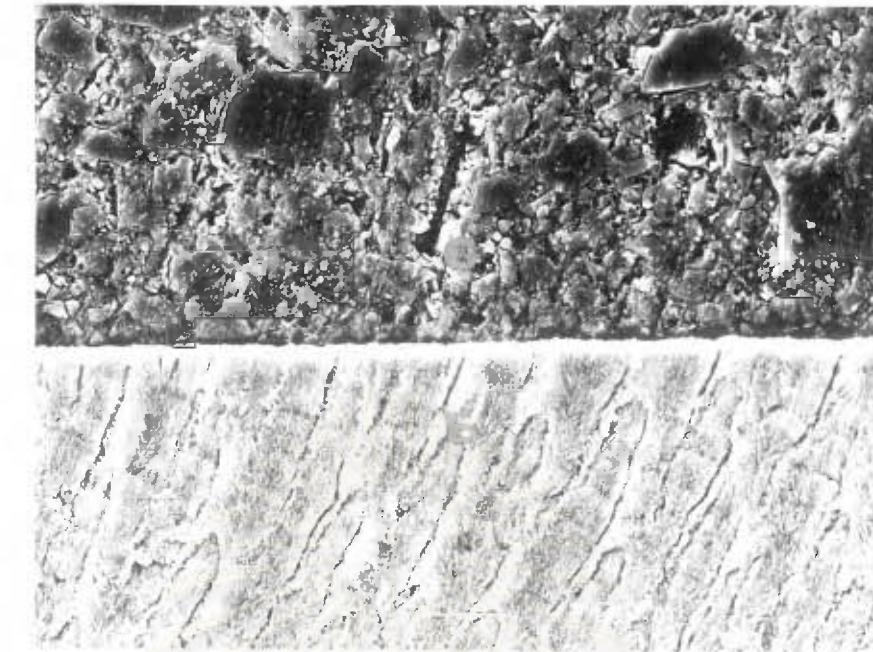
การยึดระหว่างกัลยาโน่ไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงกับผิวเคลือบฟันเมื่อเครื่ยมผิวเคลือบฟันโดยการใช้กรดกัด พบว่าเกิดจากการแทรกซึมของกัลยาโน่ไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงเข้าไปในร่องที่เกิดจากการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน (ภาพที่ 36)

การยึดระหว่างกัลยาโน่ไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงกับผิวเคลือบฟันเมื่อเครื่ยมผิวเคลือบฟันโดยการใช้กรดกัด และทำด้วยบนดิงเรชิน พบว่าเกิดจากกัลยาโน่ไอโอดีนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสงยึดกับบนดิงเรชินที่แทรกซึมเข้าไปในร่องที่เกิดจากการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน (ภาพที่ 37)

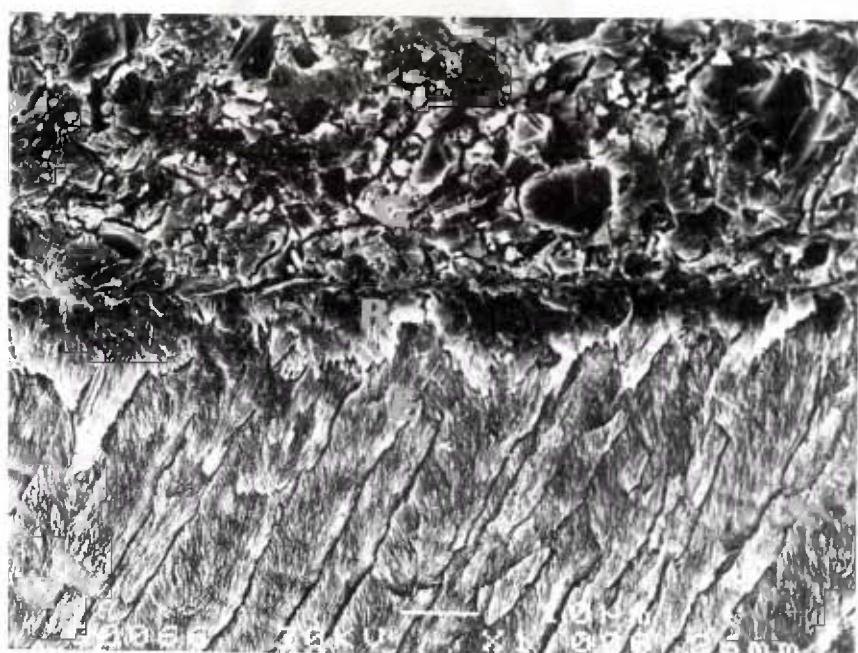


**ภาพที่ 34** แสดงบริเวณการยึดติดระหว่างคอมโพสิตเทเรซินกับผิวเคลือบฟัน

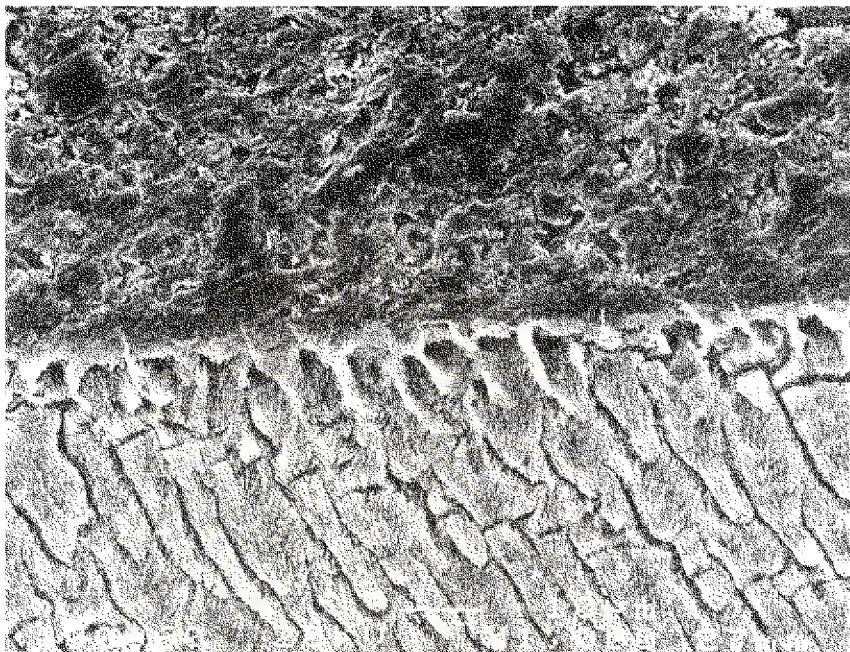
E = เคลือบฟัน B = บนดิงเรชิน R = เรชินแทก C = คอมโพสิตเทเรซิน



**ภาพที่ ๓๕** แสดงนิรเวณการขึ้นตัวระหว่างกัลต์ไอโอไโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง กับผิวเคลือบพื้นเมื่อไม่ทำการเตรียมผิวเคลือบพื้น  
E = เคลือบพื้น G = กัลต์ไอโอไโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง



**ภาพที่ ๓๖** แสดงนิรเวณการขึ้นตัวระหว่างกัลต์ไอโอไโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง กับผิวเคลือบพื้นเมื่อเตรียมผิวเคลือบพื้นด้วยการใช้กรรเก็ต  
E = เคลือบพื้น R = เกรชันแทก G = กัลต์ไอโอไโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดบ่มด้วยแสง



**ภาพที่ 37** แสดงบริเวณการขึ้นติดคราบหัวงอกกาสไอยโอยในเมอร์ซีเมนต์ชนิดป่นด้วยแร่ กับผิวเคลือบฟันเมื่อเตรียมผิวเคลือบฟันด้วยการใช้กรดกัดและทابอนดิงเรซิน E = เคลือบฟัน R = เรซินแทก B = บอนดิงเรซิน G = กาสไอยโอยในเมอร์ซีเมนต์ชนิดป่นด้วยแร่

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย